

平成27年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年11月13日

上場取引所 東

上場会社名 タツモ株式会社

コード番号 6266 URL <http://www.tazmo.co.jp/ja/ir/index.html>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 池田 俊夫

問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 亀山 重夫

TEL 0866-62-0923

四半期報告書提出予定日 平成27年11月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年12月期第3四半期の連結業績(平成27年1月1日～平成27年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期第3四半期	9,280	55.3	762	—	760	—	657	—
26年12月期第3四半期	5,977	30.1	△985	—	△957	—	△1,338	—

(注) 包括利益 27年12月期第3四半期 609百万円 (—%) 26年12月期第3四半期 △1,323百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円銭	円銭
27年12月期第3四半期	193.40	—
26年12月期第3四半期	△393.77	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円銭
27年12月期第3四半期	10,983	2,909	25.6	826.71
26年12月期	11,397	2,240	19.3	646.07

(参考) 自己資本 27年12月期第3四半期 2,815百万円 26年12月期 2,196百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円銭	円銭	円銭	円銭	円銭
26年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00
27年12月期	—	0.00	—	—	—
27年12月期(予想)	—	—	—	5.00	5.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成27年12月期の連結業績予想(平成27年1月1日～平成27年12月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円銭
通期	11,383	32.0	614	—	598	—	508	—	149.43

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

- ① 期末発行済株式数(自己株式を含む)
- ② 期末自己株式数
- ③ 期中平均株式数(四半期累計)

27年12月期3Q	3,405,900 株	26年12月期	3,400,000 株
27年12月期3Q	509 株	26年12月期	509 株
27年12月期3Q	3,401,136 株	26年12月期3Q	3,399,505 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりますが、この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (1) 経営成績に関する説明 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示	3
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	3
4. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	9
(重要な後発事象)	10
5. 補足情報	12
(受注状況)	12

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府による経済政策や日銀による金融政策の効果などにより、円安や原油安などエネルギーコストが減少し、企業収益や雇用環境の改善が見られました。しかし、一方では円安による物価の上昇の影響で個人消費は伸び悩んでおります。海外においては、米国は個人消費が堅調でしたが、欧州の債務問題や中国等の新興国での減速感の高まりによる影響など、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する半導体・液晶業界におきましては、テレビなどの大型パネル用途では設備投資が縮小しておりますが、携帯端末や自動車向け電子部品の需要が比較的堅調に推移しました。このような経営環境のなか、当社グループは、前連結会計年度において策定した再建計画に基づき、収益性の改善を図るとともに、顧客ニーズに対応した装置の開発と新規の顧客獲得のため、積極的に営業活動を展開してきました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は9,280百万円（前年同期比55.3%増）、営業利益762百万円（前年同期は営業損失985百万円）、経常利益760百万円（前年同期は経常損失957百万円）、四半期純利益657百万円（前年同期は四半期純損失1,338百万円）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

①プロセス機器事業

半導体装置部門につきましては、携帯端末向け電子部品の設備投資の増加により、当部門の売上高は1,172百万円（前年同期比165.8%増）となりました。

搬送装置部門につきましては、納期や価格は引き続き厳しい状況ですが、半導体メーカーの設備投資の増加により、売上高は2,362百万円（前年同期比73.0%増）となりました。

洗浄装置部門につきましては、国内の一部半導体メーカーの設備投資の増加により、売上高は1,512百万円（前年同期比36.1%増）となりました。

コーター部門につきましては、液晶製造装置の需要は低調でありましたが、中国向け装置が売上計上となり、当部門の売上高は3,033百万円（前年同期比67.5%増）となりました。

以上の結果、プロセス機器事業の売上高は8,081百万円（前年同期比70.9%増）、営業利益842百万円（前年同期は営業損失987百万円）となりました。

②金型・樹脂成形事業

金型・樹脂成形事業につきましては、デジタル家電向け材料を主体としております。納期、製品価格については、年々厳しさが増しております。また、中国では人件費等の上昇で厳しい状態でした。

以上の結果、金型・樹脂成形事業の売上高は1,199百万円（前年同期比3.9%減）、営業損失80百万円（前年同期は営業利益1百万円）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第3四半期連結会計期間末における資産の残高は109億83百万円となり、前連結会計年度比4億14百万円の減少となりました。これは、売上計上による「たな卸資産」の減少が主な要因です。

(負債)

当第3四半期連結会計期間末における負債の残高は80億73百万円となり、前連結会計年度比10億83百万円の減少となりました。これは、売上計上に伴う「前受金」の減少と、「長期借入金」の減少が主な要因であります。

(純資産)

当第3四半期連結会計期間末における純資産の残高は29億9百万円となり、前連結会計年度比6億69百万円の増加となりました。これは、四半期純利益の計上等による「利益剰余金」の増加が主な要因です。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成27年8月10日に公表いたしました「平成27年12月期第2四半期連結累計期間の業績予想と実績値との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」から変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

該当事項はありません。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度まで4期連続で営業損失を計上し、また、取引金融機関から返済条件の緩和も受けております。当第3四半期連結累計期間においては営業利益762百万円及び四半期純利益657百万円を計上し、平成27年12月期の通期におきましては、平成26年9月に公表いたしました再建計画の効果や大型装置の検収予定が早まったことなどから、利益計上の予定となっております。しかし、引き続き取引金融機関から返済条件の緩和を受けていることから、現時点では、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在していると認識しております。

そこで当社グループは、当該状況の解消と改善に向けて、平成26年9月に公表いたしました再建計画に基づき各施策を実施いたしております。これらの対応策はほぼ完了しており、既に効果が現れつつありますが、引き続き取引金融機関から返済条件の緩和を受けていることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、長期の業績低迷により、自己資本比率も悪化し、資金繰りにつきましては厳しい状況が続いておりますが、上記対応策を含む再建計画を取引金融機関にご理解いただきまして、運転資金の安定的な確保や返済条件の緩和など、引き続きご協力を頂ける旨のお約束を頂いております。

また、平成27年11月9日に公表いたしましたとおり、弘塑科技股份有限公司（台湾）に対する第三者割当増資を予定しております。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,214,468	1,263,699
受取手形及び売掛金	1,510,595	1,933,118
電子記録債権	1,679	490,262
たな卸資産	4,211,246	3,040,719
繰延税金資産	2,226	3,234
その他	229,305	165,774
貸倒引当金	△677	△740
流動資産合計	7,168,843	6,896,068
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	2,026,341	1,965,602
機械装置及び運搬具(純額)	597,361	484,193
土地	1,202,846	1,200,651
その他(純額)	195,974	239,492
有形固定資産合計	4,022,524	3,889,939
無形固定資産		
ソフトウェア	31,740	30,724
その他	5,997	5,760
無形固定資産合計	37,737	36,484
投資その他の資産		
投資有価証券	706	706
その他	385,171	383,117
貸倒引当金	△217,628	△222,986
投資その他の資産合計	168,249	160,837
固定資産合計	4,228,512	4,087,261
資産合計	11,397,355	10,983,330

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成27年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	1,054,166	1,545,344
短期借入金	3,767,417	3,691,008
未払金	677,728	556,174
未払法人税等	15,397	64,406
前受金	2,414,160	1,150,189
賞与引当金	16,917	82,472
製品保証引当金	128,735	174,316
その他	64,809	69,872
流動負債合計	8,139,333	7,333,783
固定負債		
長期借入金	664,806	409,129
役員退職慰労引当金	74,839	70,536
退職給付に係る負債	131,042	139,519
資産除去債務	57,129	51,276
その他	90,016	69,449
固定負債合計	1,017,834	739,911
負債合計	9,157,167	8,073,694
純資産の部		
株主資本		
資本金	1,395,240	1,399,863
資本剰余金	1,909,398	1,914,021
利益剰余金	△1,373,482	△715,686
自己株式	△729	△729
株主資本合計	1,930,426	2,597,468
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	265,897	217,815
その他の包括利益累計額合計	265,897	217,815
新株予約権	43,864	41,314
少数株主持分	—	53,037
純資産合計	2,240,188	2,909,635
負債純資産合計	11,397,355	10,983,330

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成26年1月1日 至平成26年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成27年1月1日 至平成27年9月30日)
売上高	5,977,086	9,280,877
売上原価	5,349,227	6,973,679
売上総利益	627,859	2,307,198
販売費及び一般管理費	1,613,837	1,545,057
営業利益又は営業損失(△)	△985,977	762,140
営業外収益		
受取利息	555	2,374
受取配当金	3,313	—
補助金収入	—	13,543
保険解約返戻金	31,450	—
役員退職慰労引当金戻入額	20,257	—
その他	14,852	22,885
営業外収益合計	70,429	38,803
営業外費用		
支払利息	35,433	34,035
その他	6,352	6,457
営業外費用合計	41,785	40,492
経常利益又は経常損失(△)	△957,333	760,452
特別利益		
持分変動利益	—	8,512
固定資産売却益	—	1,393
投資有価証券売却益	76,512	—
特別利益合計	76,512	9,905
特別損失		
減損損失	417,712	22,648
固定資産除却損	45,669	—
投資有価証券売却損	430	—
特別退職金	—	23,522
特別損失合計	463,812	46,170
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△1,344,633	724,186
法人税等	△5,979	66,390
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△1,338,653	657,796
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△1,338,653	657,796

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 平成26年1月1日 至 平成26年9月30日)	当第3四半期連結累計期間 (自 平成27年1月1日 至 平成27年9月30日)
少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益 調整前四半期純損失(△)	△1,338,653	657,796
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△12,799	—
為替換算調整勘定	28,173	△48,082
その他の包括利益合計	15,374	△48,082
四半期包括利益	△1,323,279	609,713
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△1,323,279	609,713
少数株主に係る四半期包括利益	—	—

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

当社グループは、前連結会計年度まで4期連続で営業損失を計上し、また、引き続き取引金融機関から返済条件の緩和を受けております。

当第3四半期連結累計期間においては、営業利益762,140千円及び四半期純利益657,796千円を計上しており、平成27年12月期通期の業績につきましては、平成26年9月に公表いたしました再建計画の効果や大型装置の検収予定が早まったことなどから、平成27年8月に公表いたしましたように利益計上の予定となっております。しかし、引き続き取引金融機関から返済条件の緩和を受けていることから、現時点では、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループが、当該状況を解消するため、平成26年9月に公表いたしました再建計画ですが、以下のとおり対応策を実施しております。

①製造原価の低減

前連結会計年度において、液晶など縮小事業を中心に希望退職者を募集し、適正な事業規模に再編して事業の効率化を図りました。各部門でさらなる製造原価の低減を実現させるため、受注、販売状況、工程管理を厳重に実施してまいります。また、当社は開発型企業であります。当面の間、売上に直結しない基礎的な研究開発を削減しております。さらに調達方法も見直し、製造原価を低減してまいります。

②工程管理の徹底

前連結会計年度において、大型装置案件の費用の大幅な増加等により多額の赤字を計上したことを深く反省し、コストダウンの活動を開始しております。

新設した生産管理部を中心に、これまで以上に設計・製造工程での工程管理を徹底し、予算との乖離が発生しないよう管理を強化しております。営業面では、受注段階で仕様を固め、仕様変更が起きないようにするとともに、利益率の高い受注に向けた営業に力を入れております。

③固定費、諸経費の削減

役員報酬の削減、賞与の減額、広告費や出張手当の見直しを行っております。また、外注費についても見直しを行い、固定費、諸経費の圧縮を継続しております。

④保有資産の売却等

前連結会計年度において、投資有価証券などを中心に非事業用資産を選別し、売却又は解約を完了しております。今後も状況を見ながら売却可能な資産の選別、資金化を進めてまいります。

⑤不採算事業の見直し

希望退職者の募集により、近年、売上が激減している液晶部門の事業を受注に見合う規模(約2分の1)まで縮小いたしました。また、不採算部門であるプロジェクト事業の廃止、海外子会社であるTAZMO KOREA CO., LTD.の解散や台湾支店の連結子会社への統合を行いました。さらに、中国の連結子会社である大連龍雲電子部件有限公司を解散及び清算し、上海龍雲精密機械有限公司に生産を移管するなど、事業の効率化を進めてまいります。

⑥資金繰り

継続的な損失計上により、自己資本比率も悪化してきております。この状況を改善するために、平成26年9月に経費削減や不採算事業の見直しなどを含む再建計画を策定、公表いたしました。この再建計画は、取引金融機関の継続的な支援を前提に策定されており、メインバンクをはじめとする取引金融機関にご理解をいただいて、運転資金の安定的な確保や返済条件の見直しなど、引き続きご協力いただける旨のお約束をいただいております。また、平成27年11月9日に公表いたしましたとおり、弘塑科技股份有限公司(台湾)に対する第三者割当増資による新株発行(発行価額の総額408,400千円)を予定しております。

以上の対応策の実施は、ほぼ完了し効果が現れつつありますが、引き続き取引金融機関から返済条件の緩和を受けていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自平成26年1月1日至平成26年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント		合計	調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業			
売上高					
外部顧客への売上高	4,729,043	1,248,043	5,977,086	—	5,977,086
セグメント間の内部売上高又は 振替高	—	20,728	20,728	△20,728	—
計	4,729,043	1,268,771	5,997,814	△20,728	5,977,086
セグメント利益又は損失(△)	△987,392	1,414	△985,977	—	△985,977

(注) 1. 調整額は、セグメント間売上の消去であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(のれんの金額の重要な変動)

「プロセス機器事業」セグメントにおいて、アプリシアテクノロジー株式会社の当初想定した超過収益力が見込めなくなったことにより、減損損失として417,712千円を特別損失に計上いたしました。

II 当第3四半期連結累計期間(自平成27年1月1日至平成27年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント		合計	調整額 (注) 1	四半期連結損益 計算書計上額 (注) 2
	プロセス機器 事業	金型・樹脂 成形事業			
売上高					
外部顧客への売上高	8,081,226	1,199,651	9,280,877	—	9,280,877
セグメント間の内部売上高又は 振替高	—	48,721	48,721	△48,721	—
計	8,081,226	1,248,372	9,329,598	△48,721	9,280,877
セグメント利益又は損失(△)	842,539	△80,399	762,140	—	762,140

(注) 1. 調整額は、セグメント間売上の消去であります。

2. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「金型・樹脂成形」セグメントにおいて、中国における事業の再編により大連龍雲電子部件有限公司を解散及び清算するため、固定資産の減損損失を計上いたしました。なお、当該減損損失の計上額は、当第3四半期連結累計期間において22,648千円であります。

(重要な後発事象)

(資本業務提携、第三者割当増資による新株発行)

当社は、平成27年11月9日開催の取締役会において、弘塑科技股份有限公司（中華民国新竹市香山区中華路六段89号 董事長 張鴻泰、以下「弘塑科技」という。）に対する第三者割当増資による新株式発行及び弘塑科技との業務提携契約の締結を内容とする資本業務提携（以下、「本資本業務提携」という。）を行うことを決議いたしました。

1. 資本提携の概要

(1) 資本業務提携の理由

当社は、主に液晶製造装置、半導体関連機器、精密金型及び樹脂成形品の製造及び販売を行っております。

近年の半導体・液晶業界におきましては、テレビなどの大型パネル用途では設備投資が縮小しておりますが、携帯端末や自動車向けの需要が比較的堅調に推移しております。

当社においては、前連結会計年度において策定した再建計画に基づき、収益性の改善を図るとともに、顧客ニーズに対応した装置の開発と新規の顧客獲得のため、積極的に営業活動を展開してきました。また、当社は投資有価証券などを中心に非事業用資産を売却し資金化を進めてまいりました。

一方、弘塑科技は、台湾の上場企業であり、主に半導体後工程の製造装置を製造販売しており、半導体後工程受託業界における世界シェア上位3社に対し大きな実績を有しております。当該市場は、半導体市場全般と比べて約2倍の成長率であり、その主戦場となっているのは台湾であります。

このような状況のなか、弘塑科技と台湾・中国における事業展開など意見を交わし、当社の半導体・液晶関連の製造分野における独自の技術と弘塑科技の営業的強みを生かし、主に台湾での協業などによる事業の拡大を図ることを目的として業務提携（以下「本業務提携」といいます。）することとしました。本業務提携により台湾・中国における販売力の強化、保守サービスの強化及び現地対応力の強化を図ることができるものと考えております。

また、近時では顧客ユーザーより高品質な製品及び新技術の提供を求められており、独自の技術の充実を図り、期待に応える必要が出てまいりました。しかし、当社は前連結会計年度まで4期連続で営業損失を計上しており、その資金を借入金により調達するには限界があり、本業務提携と併せて、資金の提携を当社より弘塑科技へ申し出てまいりました。それにより、弘塑科技より当社の事業及び経営に理解をして頂き、出資の賛同を得る事になりました。本第三者割当増資によって資金を調達し、研究開発を推し進めることは、技術力の強化及び当社の財政状態の安定化を図るものとなります。さらに弘塑科技とパートナー関係強化を図ることは、当社の売上及び利益の増加につながるものと判断したため、弘塑科技を割当予定先として選定いたしました。

(2) 資本業務提携の内容等

①業務提携の内容

今回提携する業務の範囲は、以下を骨子とするものであります。

ロボット関連 : 当社から弘塑科技への技術供与により現地生産化

半導体 洗浄装置 : 主に台湾・中国市場での装置・部品販売、保守サービス、現地対応力の強化

半導体 塗布/現像装置 : 主に台湾・中国市場での装置・部品販売、保守サービス、現地対応力の強化

詳細については、これから両社で協議してゆくこととなりますが、両社が上記業務において協業してゆくことは、今後、中長期的にみて両社の売上及び利益の増加につながるものと考えております。

②資本提携の内容

当社は、弘塑科技との業務提携をより強固なものとするため、第三者割当増資により、弘塑科技に当社の普通株式400,000株を割当てます。本第三者割当増資後に、弘塑科技が所有することになる当社株式の割合は、発行済み株式総数に対して10.51%の割合となります。資本提携の詳細は、後記「2 本第三者割当増資について」をご参照ください。

(3) 日程

平成27年11月9日	取締役会決議
平成27年11月9日	資本業務提携契約および株式引受契約書締結
平成27年11月30日	第三者割当増資の払込日

(4) 資本業務提携の相手先の概要

割当予定先の概要

名称 弘塑科技股份有限公司
所在地 中華民国新竹市香山区中華路六段89号
代表者 董事長 張鴻泰
事業内容 電子と半導体生産設備の製造・メンテナンス事業
資本金 246,838千NT\$ (約9億円)

2. 本第三者割当増資について

(1) 募集の概要

- ①払込日 平成27年11月30日
②発行新株数 普通株式400,000株
③発行価額 1株につき1,021円
④発行価額の総額 408,400,000円
⑤資本組入額 1株につき510.5円
⑥資本組入額の総額 204,200,000円
⑦募集又は割当額の総額 第三者割当の方法により、弘塑科技股份有限公司に400,000株を割当てます。
(割当予定先)
⑧その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします。

(2) 本第三者割当増資の目的及び理由

前記「1 資本提携の概要」をご参照ください。

(3) 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

①調達する資金の額

払込金額の総額 408,400,000円
発行諸費用の概算額 29,000,000円
差引手取概算額 379,400,000円

②調達する資金の具体的な使途

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
半導体製造装置開発 (注1)	210,000,000円	平成28年1月～平成29年12月
分散型無機EL開発 (注2)	91,000,000円	平成28年1月～平成28年12月
液晶製造装置開発 (注3)	52,000,000円	平成28年1月～平成28年12月
産業用ロボット開発等 (注4)	20,000,000円	平成28年1月～平成28年12月

(注1) 半導体製造装置の製造に関し、他社と差別化を図り優位性を確立するため、半導体製造工程におけるウェハ仮接合のための新規装置の開発等に充当する予定です。

(注2) 当社はプロセス機器事業の新規分野として分散型無機EL照明に注力しており、その性能向上のための開発等に充当する予定です。

(注3) 液晶製造装置に関し、他社と差別化を図り、優位性を確立するため、塗布技術の開発等に充当する予定です。

(注4) 半導体製造工程間のウェハを搬送させる産業用ロボットの性能向上のための開発等に充当する予定です。

(注5) 調達資金を実際に支出するまでは、銀行口座にて管理いたします。

5. 補足情報

(受注状況)

当第3四半期連結累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (千円)	受注残高 (千円)
プロセス機器事業	7,219,020	4,277,810
半導体装置	2,367,925	1,831,542
搬送装置	2,751,229	1,236,613
洗浄装置	1,522,549	736,708
コーター	577,316	472,944
金型・樹脂成形事業	1,152,710	165,402
合計	8,371,730	4,443,212

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。